

tesa HAF® 8414

Ürün Bilgisi



yarı saydam z-eksenli iletken ısı ile etkinleşen film

Ürün Açıklaması

tesa® HAF 8414, elektriksel olarak iletken parçacıklar içeren yarı saydam bir ısıyla etkinleşen yapışkan filmidir.

Özellikler

- Çip modül yapıştırma ve elektriksel bağlantı tek adımda
- Tüm yaygın implant hatlarında iyi işlenebilirlik
- PVC, ABS ve PC kartlar için uygun (Dual Interface (D.I.) ve temassız kartlar)
- Gümüş mürekkep altlıkları ve tel anten için uygun
- Ortalama parçacık çapı: 40 µm

Uygulama Alanları

tesa® HAF 8414, güvenilir elektrik bağlantılarının ve güçlü yapışmanın gerektiği tüm uygulamalar için tasarlanmıştır. Başlıca uygulama alanları, Dual Interface (DI) kartlarında çip modül gömme ve RFID etiketleridir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| • Taşıyıcı malzeme | yok | • Koruyucu türü | glasin |
| • Yapışkan türü | copolyamide | • Renk | yarı saydam |

Ek Bilgiler

İşleme:

Lütfen, optimum parametrelerin kullanılan makine tipi, kart gövdesi için özel materyaller, anten materyali veya çip modülleri ile bireysel müşteri gereksinimlerine büyük oranda bağlı olduğunu unutmayın. Yapıştırma süresi, kullanılan altlıkların ısı geçişine bağlıdır. Ayrıca, yapıştırma işleminden hemen sonra bir soğutma aşaması öneririz. Bu esnada, filmin sıcaklığı yumuşama sıcaklığının (yaklaşık 110 °C) altına düşene kadar basınç uygulanmalıdır.

Aşağıdaki veriler, makine parametrelerinin ilk kurulumu için önerilerdir.

1. Ön laminasyon:

Ön laminasyon sırasında, yapışkan bant modül bandına lamine edilir. tesa® HAF 8414 için özellikle doğru bir ön laminasyon, nihai üründe iyi bir yapışma ve iyi iletkenlik sağlamak açısından büyük öneme sahiptir.

Makine ayarı:

- Sıcaklık 130 - 150 °C

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=8414>

tesa HAF® 8414

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Basınç 3 - 4 bar
- Süre 2,5 m/dak.

2. İletken Yapıştırma:

Modül gömme sırasında, önceden lamine edilmiş modüller modül bandından hassas bir şekilde kesilir, kart yuvasına yerleştirilir ve ısı ve basınç ile kart gövdesine kalıcı olarak tutturulur. İmplant hatlarının tipine göre tek veya çok adımlı işlem kullanılabilir. Günümüzde, çoğu implant makinesinde birden fazla ısı presleme adımı bulunmaktadır.

Tek adımlı işlem - Makine ayarı:

- Sıcaklık¹ 160 – 220 °C
- Basınç 65 - 130 N/modül
- Süre 1,5 s

Çok adımlı işlem (2 veya daha fazla ısı baskı kafası) - Makine ayarı:

- Sıcaklık¹ 180 – 220 °C
- Basınç 65 - 130N/modül
- Süre 2 x 0,7 s. / 3 x 0,5 s.

¹Sıcaklık önerileri, ısıtma kafasında ölçülebilen değerlere dayanmaktadır. Farklı kart materyalleri için farklı sıcaklık ayarları tavsiye edilir:

- PVC 180 – 190 °C
- ABS 180 – 190 °C
- PET 190 – 200 °C
- PC 200 – 220 °C

Maksimum yapışma dayanımı için yüzeylerin temiz ve kuru olması gerekmektedir. Depolama koşulları, tesa® HAF raf ömrü konseptine göre olmalıdır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=8414>